

2020학년도 후기(2021.08) 졸업사정(본인확인용)

순번	학번	판정	졸업형태	논문제목(국문)	논문제목(영문)
1	199827058	졸업	학점		
2	201572069	수료			
3	201572150	수료			
4	201672056	졸업	논문	수소라디칼 반응을 이용한 플라즈마 원자층 공정의 실리콘 질화막 특성 향상	
5	201672079	수료			
6	201672091	졸업	학점		
7	201672104	졸업	논문	압력 용기로의 분말주입을 위한 주입장치 개발 및 운전특성에 관한 연구	A Study on the Development and Operation Characteristics of Injection Device for Powder Injection into Pressure Vessel
8	201772001	수료			
9	201772007	졸업	학점		
10	201772100	수료			
11	201772101	수료			
12	201772107	졸업	논문	밀링커터 세팅방식이 표면거칠기에 미치는 실험적 연구	
13	201872004	졸업	논문	용접형태에 따른 스테인리스의 인장강도와 응력 비교분석	Welding type based Tensile strength & Stress Analysis of Stainless steel
14	201872013	수료			
15	201872018	졸업	논문	차체 외판용 CFRP의 섬유적층각도에 따른 기계적 특성 예측	Prediction of mechanical properties according to the fiber stacking angle of CFRP for body Exterior
16	201872047	졸업	학점		
17	201872080	졸업	학점		
18	201872086	졸업	학점		
19	201872092	졸업	학점		
20	201872101	졸업	학점		
21	201872107	졸업	학점		
22	201972007	졸업	학점		
23	201972011	졸업	논문	디스플레이 장비 제작 시 실패비용 추산방법 도출에 관한 연구	A Case Study on Internal Failure Cost Estimation for Display Equipment Manufacturing
24	201972015	졸업	학점		
25	201972017	졸업	학점		
26	201972019	수료			
27	201972023	수료			
28	201972024	졸업	학점		
29	201972028	수료			
30	201972034	수료			
31	201972036	졸업	학점		
32	201972053	불가			
33	201972054	수료			
34	201972058	졸업	논문	열풍을 활용한 적층 어셈블리 PCB의 리플로우 솔더링 가능성에 관한 연구	A Study on the Possibility of Reflow Soldering of Stacking Assembly PCBs Using Hot Air

2020학년도 후기(2021.08) 졸업사정(본인확인용)

순번	학번	판정	졸업형태	논문제목(국문)	논문제목(영문)
35	201972059	졸업	학점		
36	201972079	수료			
37	201972088	수료			
38	201972113	졸업	학점		
39	201972114	졸업	논문	반도체 제조 공장 Diffusion Furnace 장비의 온도 예측을 위한 물리 기반 모델과 데이터 기반 모델의 혼합 방법	Hybrid Method of Physical Based Model And Data-Driven Model (HMPD) for Predicting Temperature of Diffusion Furnace in a semiconductor FAB
40	201972115	졸업	학점		
41	201972117	수료			
42	201972118	졸업	학점		
43	201972119	졸업	학점		
44	201972123	졸업	학점		